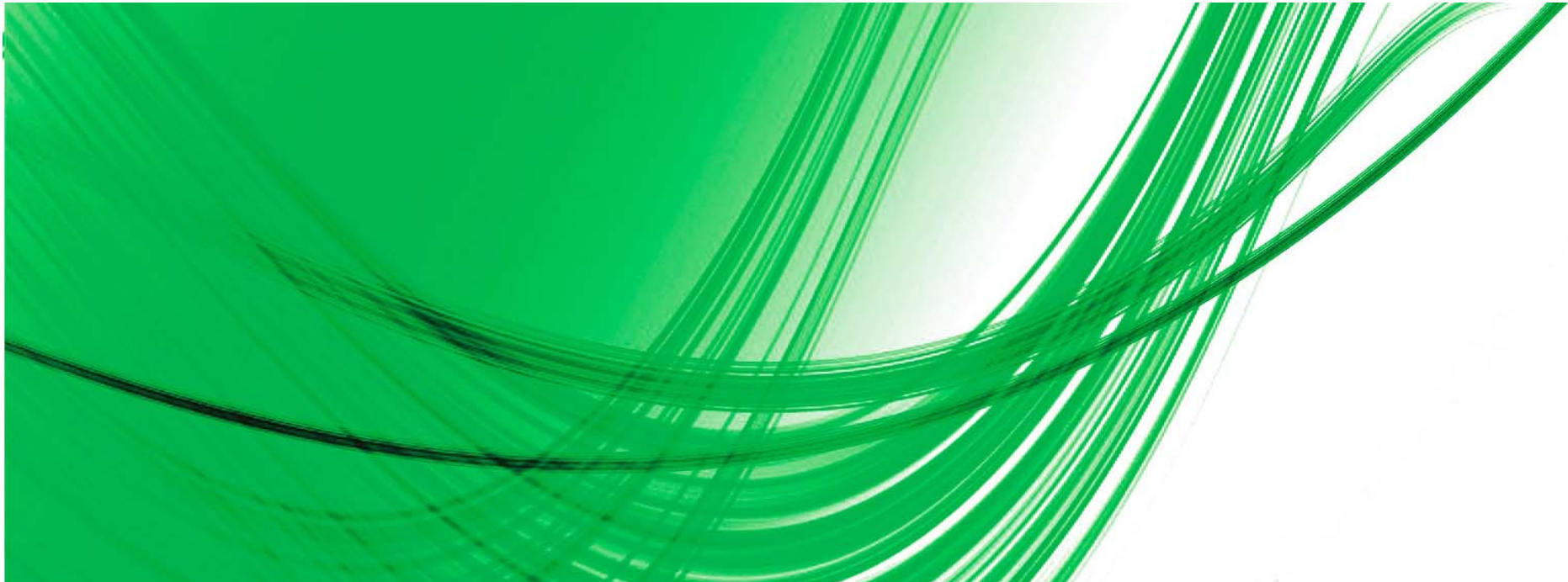


株式会社テラプローブ 決算説明資料

2014年3月期 第2四半期

2014年3月期 第2四半期 業績説明



今回の発表の概要

メモリ事業

- スマートフォンなどの好調により、モバイル用DRAMは好調持続
- ゲーム用メモリなどその他メモリの受託数量増

システムLSI事業

- テスト受託は増加傾向で推移
- WLP・BUMP受託加工は受託数量が緩やかに増加



**前四半期に比べ全体的に
売上が増加し、利益が改善**

2014年3月期 第2四半期 実績

(億円)

	前年同期比較(累計)			前四半期比較		
	1H/FY2012	1H/FY2013	YoY増減	1Q/FY2013	2Q/FY2013	QoQ増減
メモリ	80.9	78.8	-2.1	36.9	41.9	5.0
システムLSI	34.4	29.9	-4.5	14.3	15.6	1.3
その他	-0.2	-0.8	-0.6	-0.3	-0.6	-0.3
売上高	115.1	107.9	-7.2	50.9	57.0	6.1
メモリ	12.3	8.6	-3.7	2.1	6.5	4.4
システムLSI	-0.1	-1.6	-1.5	-1.0	-0.6	0.4
その他	-7.5	-6.2	1.3	-3.2	-3.1	0.1
営業利益	4.7	0.7	-4.0	-2.1	2.8	4.9
営業利益率	4%	1%	—	—	5%	—
当期純利益	3.6	0.3	-3.3	-2.0	2.4	4.4
当期純利益率	3%	0%	—	—	4%	—

2014年3月期 第2四半期実績増減分析(売上高)

2013年度第2四半期累計実績(YoY)

<メモリ事業>

- ・PC向け製品減でウエハ総数減少したことにより、売上高が減少

<システムLSI事業>

- ・テスト受託は増加したが、WLP・BUMP受託加工の大幅減少により売上高が減少

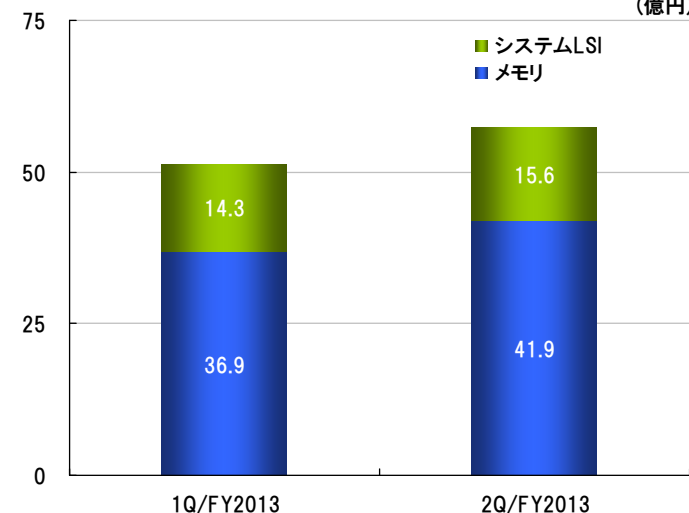
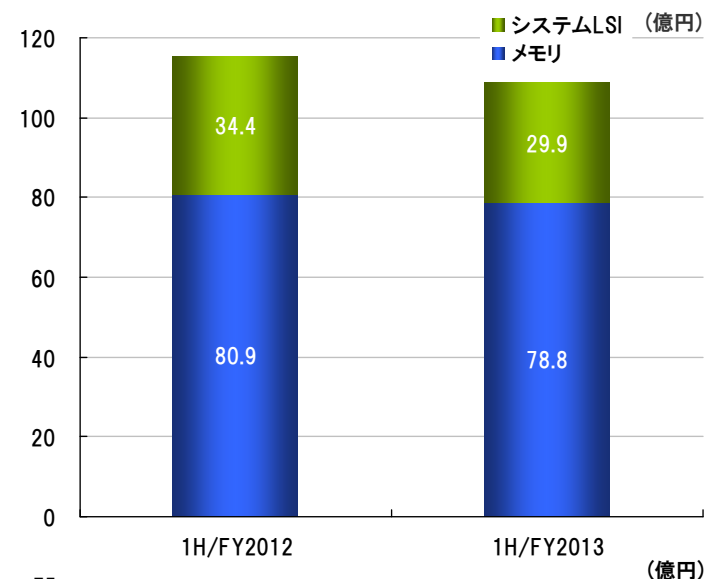
2013年度第2四半期実績(QoQ)

<メモリ事業>

- ・モバイル向け製品の増加により売上高が増加、またゲーム向けなどその他メモリも売上高が増加

<システムLSI事業>

- ・テスト受託、WLP・BUMP受託加工とも緩やかな増加により売上高が増加



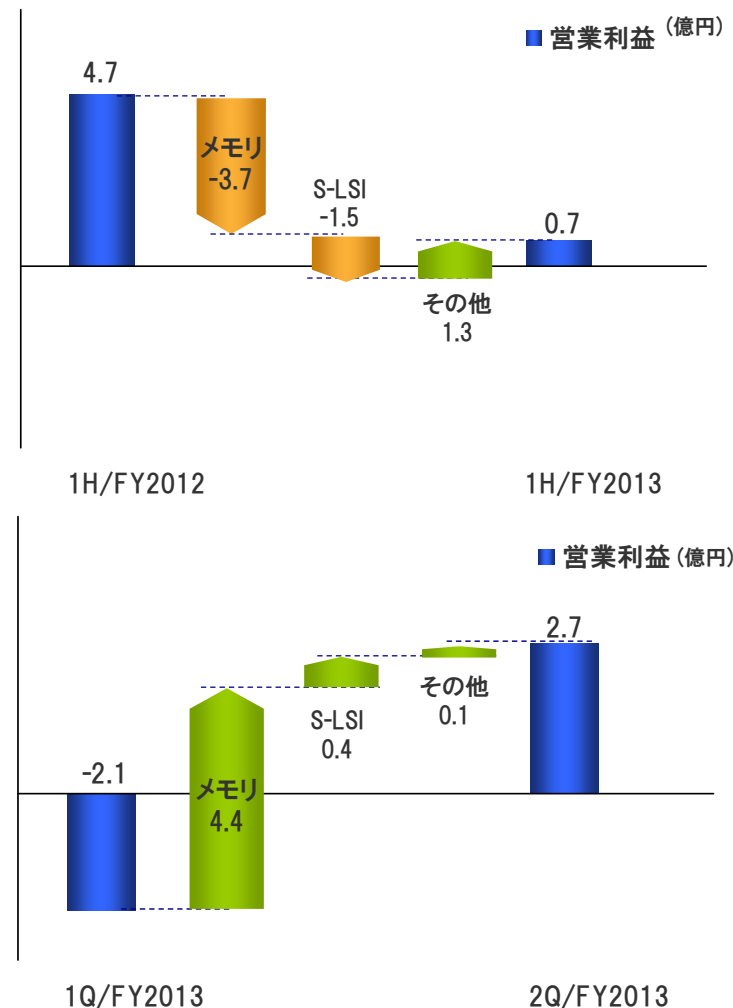
2014年3月期 第2四半期実績増減分析(営業利益)

2013年度第2四半期累計実績(YoY)

- ・メモリ事業は売上高の減少と一時的な費用の増加があり、利益が減少
- ・システムLSI事業はテスト受託が黒字を確保するがWLP・BUMPの売上高減少により、収益が悪化
- ・役員報酬をはじめ、人件費の削減などによりその他の業績が改善

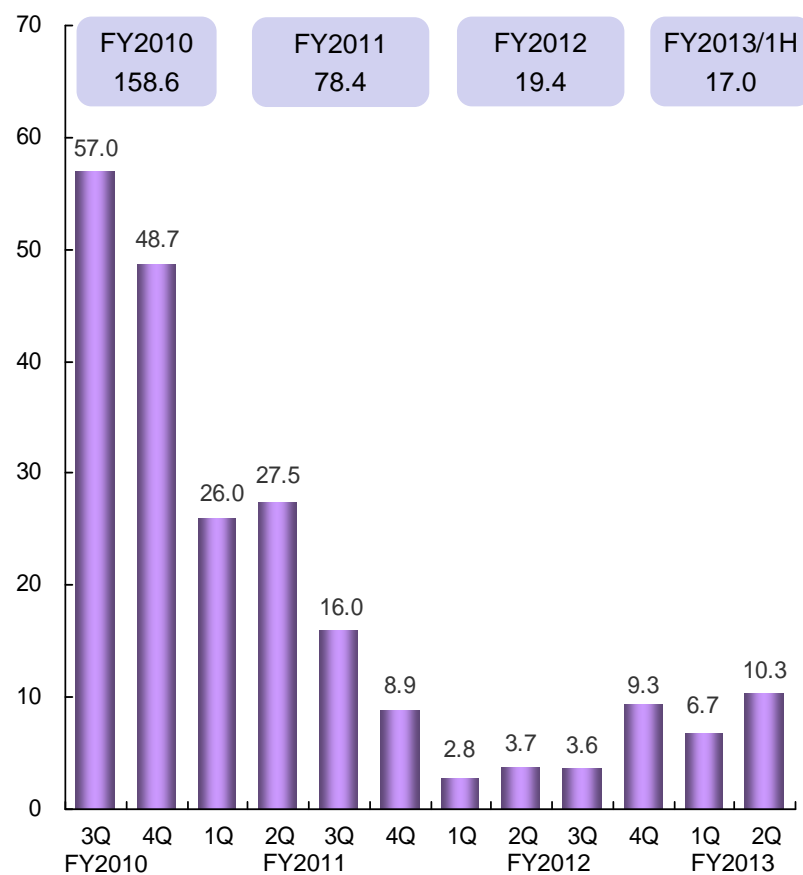
2013年度第2四半期実績(QoQ)

- ・メモリ事業は売上高の増加により、収益が改善
- ・システムLSI事業は売上高の増加により収益がゆるやかに改善

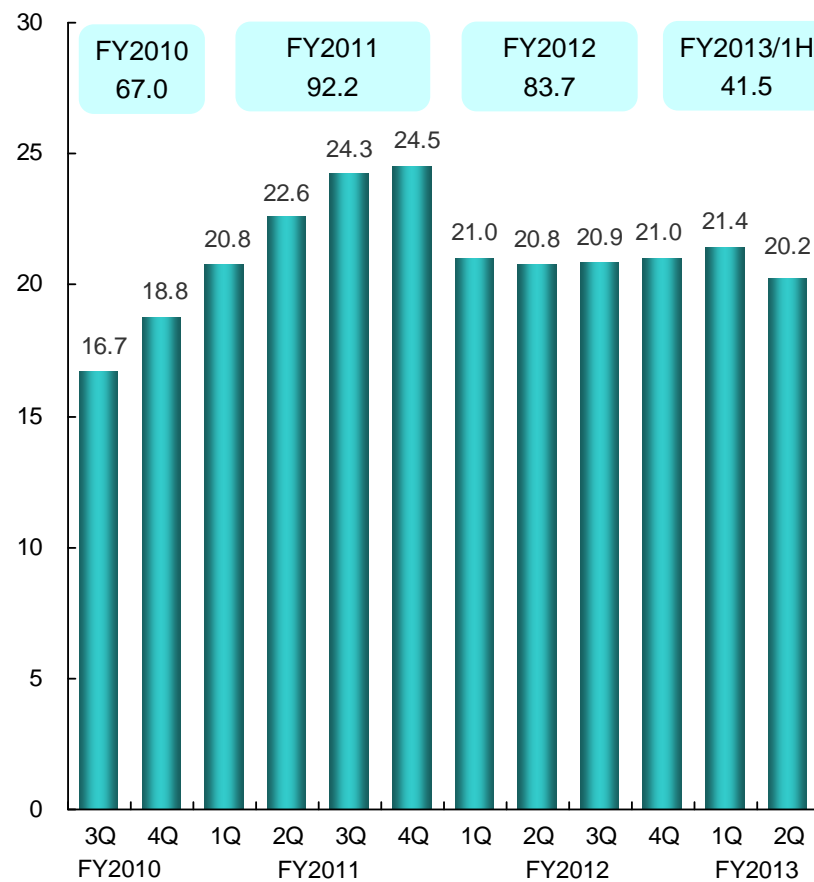


設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移

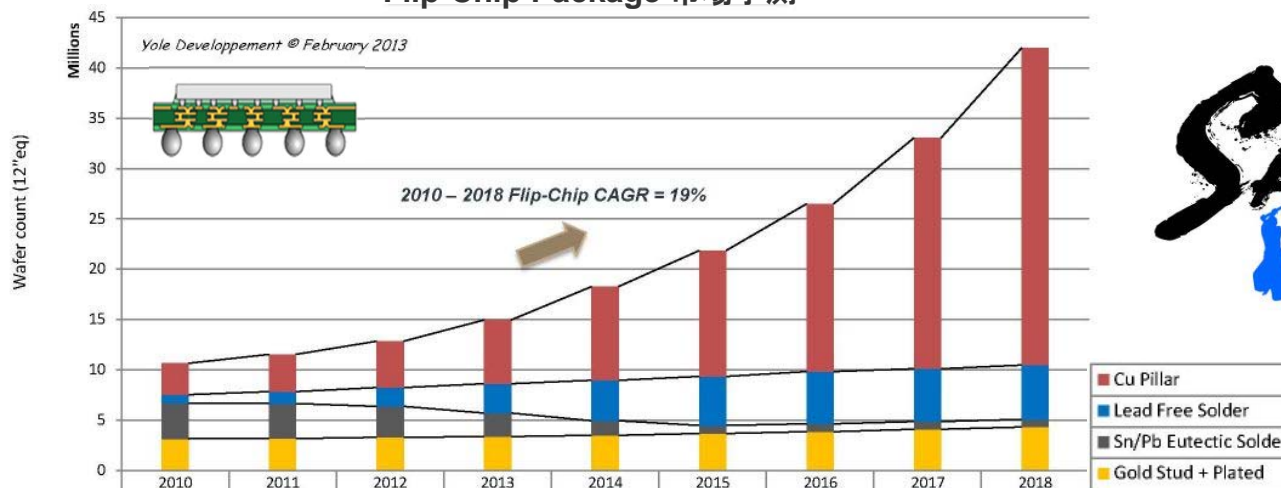


単位: 億円

SAMURAI CSP Provider

- 10月1日付で100%子会社である株式会社テラマイクロス(TMJ)を吸収合併
 - TMJが担っていたWLPビジネスユニットを、
「Advanced CSP & BUMPビジネスユニット」に改称
— 従来のWLPに加え、BUMP、再配線など領域を拡大
- ⇒ ウエハテスト — CSP & BUMP — ファイナルテスト — Tape & Reel
という、日本で培ったCSPとテストを一貫して提供(ターンキーサービス)

Flip-Chip Package 市場予測



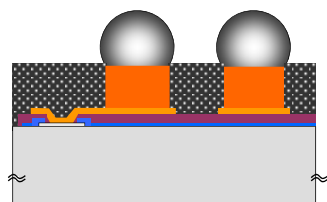
SAMURAI侍
CSP Provider

SEMICON Japan 2013
ホール1 に出展します

WLP (Wafer Level Package)

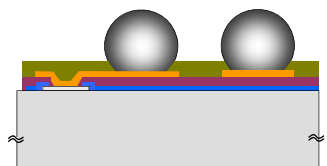
[単位: μm]

Post Type



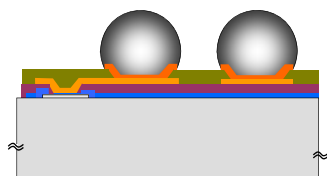
- ・デバイスの完全保護構造
- ・高信頼性(単体、実装)
- ・Low-k、U-Low-Kデバイス対応
- ・パワー/大電流デバイス対応
- ・大型/多ピン(～10mm \square 、800pin)デバイス対応
- ・MEMS/CIS対応

Type V *



- ・ローコスト
- ・シンプル構造
- ・小型デバイス向け
- ・ディスクリート向け

Type U *



- ・他社コンパチ構造 (CuめっきUBM)
- ・高実装信頼性
- ・中型(～6mm \square)
- ・汎用デバイス向け

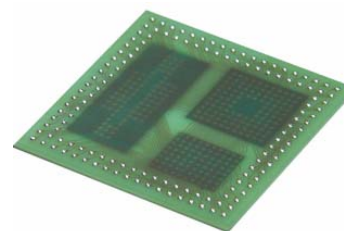
For EWLP



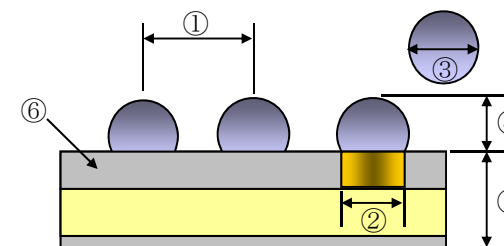
- ・基板(PCB)内蔵向けWLP
- ・KGDとして埋め込み可能
- ・超薄型フラット構造
- ・基板材料との親和性、安全内蔵

	Post Type	For EWLP
	Typ. (min)	Typ.(min)
Pitch ①	300 (200)	300 (200)
Post ϕ ②	150 (100)	150 (100)
Ball ③	150-300	-
端子高 ④	80-240	-
Chip厚み ⑤	400 (200*)	200* (100*)
保護材料 ⑥	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂

* DBGプロセス



【EWLP内蔵基板】



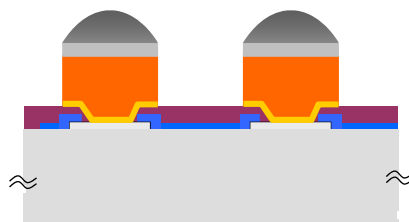
Cu Pillar /Micro Bump for Flip Chip

フリップ・チップ接続用端子として、Cu Pillar Bump / Micro Bumpを提供

[単位: μm]

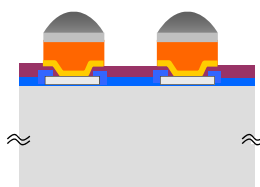
	Cu Bump	FP- Cu Bump	UFP- Cu Bump	Micro Bump
Pitch	400-250	~80	~40	~ 50
端子径	250-120	~50	~20	~ 20
端子構造	SnAg/Ni/Cu	SnAg/Ni/Cu	SnAg/Ni/Cu SnAg/Cu	SnAg/Ni
端子高さ	120-135	50-70	20-40	20-30
Chip厚み	150~	150~	150~	150~

Cu Pillar Bump

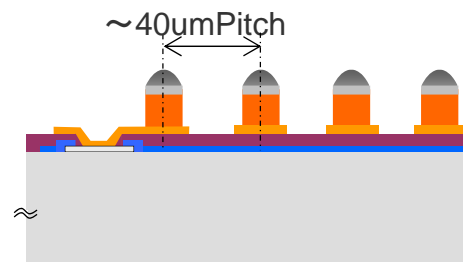


Fine Pitch
Cu Pillar Bump

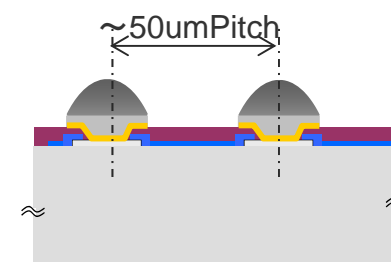
(w/o RDL) (Option : with RDL / High Bump)



Ultra Fine Pitch
Cu Pillar Bump



Micro Bump
(Solder)



2014年3月期第3四半期業績予想



2014年3月期 第3四半期業績予想の概要

メモリ事業

- モバイル用DRAMやその他メモリ製品の受託が前四半期に比べ減少傾向で推移

システムLSI事業

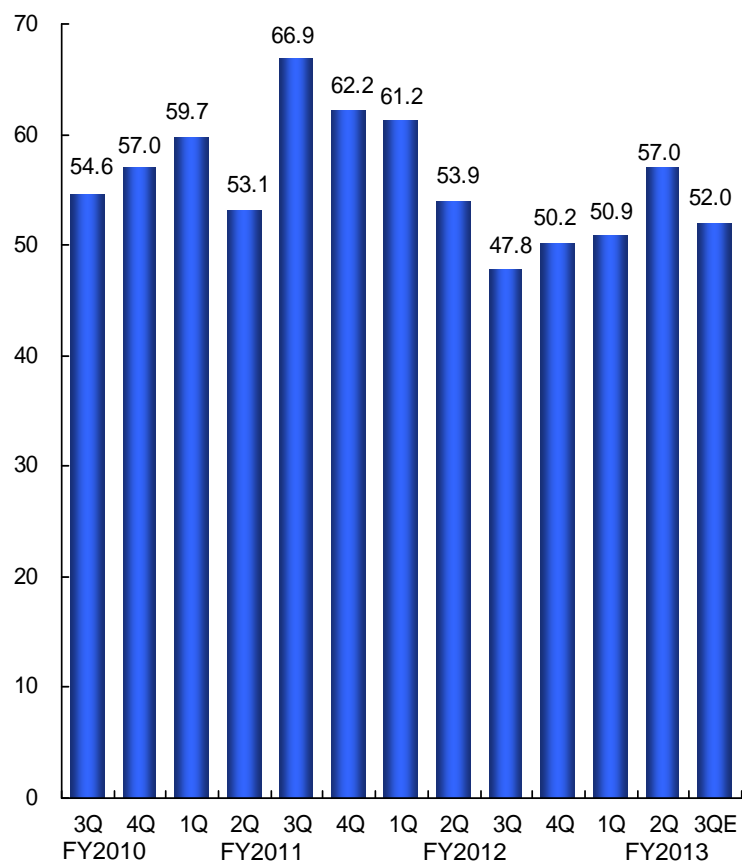
- テスト受託、WLP・BUMP受託加工とも前四半期より緩やかに減少



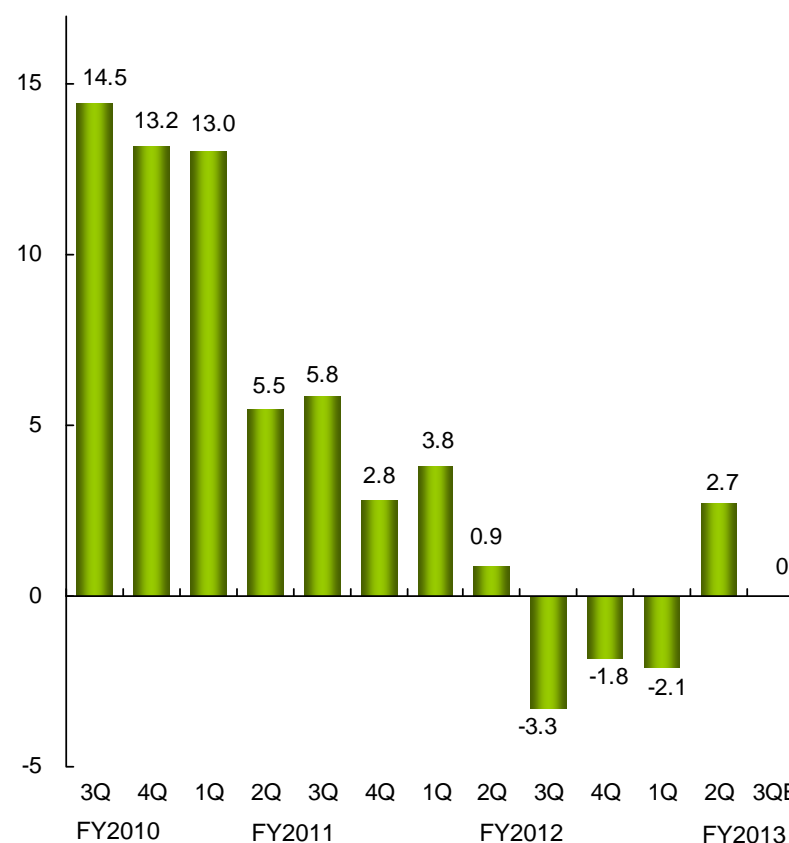
**季節要因もあり、売上、利益ともに
前四半期を下回る予想**

売上高及び営業利益推移

売上高推移



営業利益推移



単位:億円

当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、2013年11月1日において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成26年3月期第2四半期決算短信」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門
TEL (045)476-5711
URL <http://www.teraprobe.com>